

## PRODUKTENTWICKLUNG IM DISRUPTIVEN UMFELD

28. Juni 2017 | Forum

29. Juni 2017 | Konferenz

**SSP 2017**

MITVERANSTALTER

### VORWORT



Produkte entstehen heute nicht mehr nur in stabilen Wertschöpfungsketten, sondern immer häufiger in dynamischen Netzwerken und variablen Partnerschaften. Auch die Geschäftsmodelle ändern sich und werden an das Produkt angepasst oder als Teil des Produkts weiterentwickelt. Das stellt die Produktentwicklung vor große Herausforderungen.

Der Produktbegriff selbst unterliegt ebenfalls dem Wandel: Produkte sind inzwischen mehr als materielle Güter. Der Begriff »Produkt« an sich steht für individualisierte Dienste, die den Bedarf der Kunden passgenau abdecken. Mit der Virtualisierung der Entwicklung und der Digitalisierung der Produktion geht mit der Industrie 4.0 ein Wandel der Wertschöpfung einher. Die Schwerpunkte verlagern sich von der Mechanik zur Elektronik, von der Hardware zur Software und neuerdings von der Software zu den Daten.

Bereits zum vierten Mal bietet das Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP am 28. und 29. Juni 2017 eine Dialogplattform für Fachleute unterschiedlicher Disziplinen der Produktentwicklung aus Industrie und Wissenschaft.

Gemeinsam mit dem Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design IKTD, dem Institut für Maschinenelemente IMA und dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart laden wir Sie herzlich ein, mit uns den Wandel in Innovation und Entwicklung zu gestalten. Auf dem Industrieforum am ersten Tag präsentieren Vertreter von Unternehmen Strategien und tauschen ihre Erfahrungen aus der Praxis aus. International bekannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen auf der Konferenz am zweiten Tag ihre Ansätze und Forschungsergebnisse vor.

Nutzen Sie die Gelegenheit und erhalten Sie Einblick in spannende Best-Practice-Beispiele und erfolgreiche Strategien der Produktentwicklung. Wir freuen uns, mit Ihnen neue Ansätze zu diskutieren und den interdisziplinären Wissenstransfer zu gestalten!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wilhelm Bauer

Prof. Dr.-Ing. Bernd Bertsche

Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. Dr. h. c. Dieter Spath

## PROGRAMMÜBERSICHT

### Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung 2017

#### 28. Juni 2017 | Forum

**9.00 Uhr** Plenarveranstaltung  
»Produktentwicklung im  
dynamischen Umfeld«

**12.30 Uhr** Forschung aktuell

**14.00 Uhr** Plenarveranstaltung  
»Produktentwicklung im  
dynamischen Umfeld«

**17.00 Uhr** Ende des Forums

**19.00 Uhr** Get-together

Weitere Einzelheiten zum Ablauf des Forums finden Sie ab  
Herbst 2016 auf unserer Webseite unter  
[www.iao.fraunhofer.de/vk367.html](http://www.iao.fraunhofer.de/vk367.html)

#### 29. Juni 2017 | Konferenz

**8.30 Uhr** Begrüßung und Keynotes

**10.30 Uhr** Parallelstreams

**16.30 Uhr** Ende der Konferenz

Weitere Einzelheiten zu den Papers finden Sie nach dem  
Abschluss des Review-Prozesses ab Mai 2017 auf unserer  
Konferenz-Webseite unter  
[www.iao.fraunhofer.de/vk372.html](http://www.iao.fraunhofer.de/vk372.html)

## ALLGEMEINE HINWEISE

### FpF

Verein zur Förderung  
produktionstechnischer Forschung e.V., Stuttgart

**ANMELDUNG** | Die Anmeldung erfolgt anhand der  
beiliegenden Karte oder im Internet unter folgender Adresse:  
[www.iao.fraunhofer.de/vk367.html](http://www.iao.fraunhofer.de/vk367.html)

**ANMELDESCHLUSS** | 12. Juni 2017

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin damit einver-  
standen, dass seine/ihre persönlichen Daten erfasst und zu Informationszwecken  
verwendet werden sowie die im Zusammenhang der Veranstaltung gemachten  
Fotos ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen.

**TEILNAHMEGEBÜHR** | Die Teilnahmegebühr beträgt 495 €  
pro Person für das Forum und 195 € pro Person für die Konfe-  
renz. Beide Tage können zum Gesamtpreis von 595 € pro Person  
gebucht werden. Speisen und Getränke für das Get-together am  
Abend des 28. Juni sind nicht im Preis enthalten.

**FRÜHBUCHERRABATT** | Bei Anmeldung bis 31. März 2017  
wird ein Frühbucherrabatt in Höhe von 50 € auf die Anmeldung  
zum Forum oder die Anmeldung zum Forum und zur Konferenz  
gewährt.

**ABMELDUNG** | Bei einer Abmeldung bis zum 2. Juni 2015  
werden 75 € Bearbeitungsgebühr berechnet. Bei späterer  
Abmeldung oder Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr  
in Rechnung gestellt. Eine Umschreibung der Anmeldung auf  
einen anderen Teilnehmer/eine andere Teilnehmerin ist jederzeit  
kostenlos möglich. Um rechtzeitige Mitteilung wird gebeten.

**VERANSTALTUNGSORGANISATION** | Fraunhofer IAO,  
Veranstaltungsmanagement, Telefon +49 711 970-2080,  
[event@iao.fraunhofer.de](mailto:event@iao.fraunhofer.de)

**INFORMATIONEN ZUM FORUM** | Fraunhofer IAO,  
Tilman Naujoks, Telefon +49 711 970-2086,  
[ssp2017@iao.fraunhofer.de](mailto:ssp2017@iao.fraunhofer.de)

**INFORMATIONEN ZUR KONFERENZ** | IKTD der  
Universität Stuttgart, Daniel Roth, Telefon +49 711 685-60240,  
[ssp2017@iao.fraunhofer.de](mailto:ssp2017@iao.fraunhofer.de)

### TAGUNGSORT

**SSP 2017 | Forum am 28. Juni 2017**

Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart,  
Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart

**SSP 2017 | Get-together am 28. Juni 2017**

Wir freuen uns auf ein Get-together der Forums- und  
Konferenzgäste in ungezwungener Atmosphäre.  
Plätze reservieren wir für Sie!

**SSP 2017 | Konferenz am 29. Juni 2017**

Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart

**VERANSTALTER** | Verein zur Förderung produktions-  
technischer Forschung (FpF) e.V., Stuttgart und Fraunhofer IAO,  
Stuttgart

**MITVERANSTALTER** | Institut für Konstruktionstechnik  
und Technisches Design IKTD, Institut für Maschinenelemente  
IMA und Institut für Arbeitswissenschaft und Technologie-  
management IAT der Universität Stuttgart

**KOOPERATIONSPARTNER** | VDI Württembergischer  
Ingenieurverein e. V. und Wissenschaftliche Gesellschaft für  
Produktentwicklung WiGeP e. V.



Württembergischer Ingenieurverein



Wissenschaftliche Gesellschaft  
für Produktentwicklung WiGeP  
Berliner Kreis & WGMK